

澜起科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：澜起科技

证券代码：688008

编号：2026-011

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	详见附件
时间	2026年9月15日~16日
地点	公司会议室
出席人员	公司董事会秘书傅晓女士等
投资者关系活动主要内容介绍	一、交流的主要问题及答复 问题1：公司是如何成为内存接口芯片的行业领跑者的？这个领域是否会有新进入者影响当前竞争格局？ 答复：公司聚焦内存接口芯片赛道，紧跟JEDEC标准与内存技术的发展脉络，先后推出覆盖DDR2至DDR5全系列的内存接口芯片产品。在这一过程中，行业格局经历了演变：DDR2世代全球同类产品供应商可能超过10家，经过市场竞争和淘汰，到DDR3世代缩减至5家左右，DDR4世代进一步集中为3家，DDR5世代维持3家供应商的格局。 公司逐步成为行业领跑者，关键在于对技术路线的准确判断与持续高强度的研发投入。在DDR4世代，公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架被JEDEC采纳为国际标准，标志着公司从行业追赶者逐步成为行业领跑者；进入DDR5世代，公司牵头制定相关内存接口芯片的国际标准，在技术架构定义等核心环节有重要话语权。目前，DDR5世代已进入子代迭代阶段，公司在研发进度上保持领先，并持续巩固市场地位。 内存接口芯片领域存在极高的技术和商务门槛，新进入者即便从现在开始布局，也很难在中短期内对现有竞争格局产生实质性影响。 首先，该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路，产品研发难度大，需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验，且该产品的关键和基础专

	利主要由行业龙头持有，新进入者不仅需要较长时间构建自身技术能力，还需确保产品设计不侵犯已有专利。 其次，新进入者需要及时获取JEDEC标准的最新进展，并在产品定义早期即与主流CPU厂商、内存厂商开展技术交流，这要求其具备相应的行业资源与沟通渠道，才能保证产品设计与未来标准方向相兼容。 再者，产品研发完成后还需经过主流CPU厂商、内存模组厂商及系统厂商的严格测试与验证，方能启动客户导入，而该领域的下游客户与合作伙伴多为全球行业龙头，对供应商的技术实力、产品稳定性、供货能力均有较高要求，商业准入门槛极高。 最后，内存接口芯片从研发到验证导入的完整周期较长，若新进入者现在开始布局主流代际产品，即便最终能够完成客户导入，相关产品可能已进入生命周期尾声，难以形成有效的商业回报。 问题2：请问AI推理及Agent应用的快速发展，对内存互连芯片市场需求的影响有哪些？ 答复：内存互连芯片需求与内存模组需求直接相关。综合来看，AI推理及Agent应用的快速发展将从需求总量、单机用量、单模组价值量三个维度，共同推动内存互连芯片市场规模持续扩大。具体逻辑如下： 1. CPU需求增长，带动内存模组需求。AI工作负载正在从训练端大规模向推理端及智能体迁移，这对系统的逻辑判断、任务调度与实时交互能力提出了更高的要求，CPU的通用计算架构价值凸显。AI服务器中CPU与GPU的配置比例预计将持续提升，全球服务器CPU需求量将稳步增长。因此，服务器CPU需求增长将直接带动内存模组需求总量提升。 2. CPU内存通道数增加，提升单机内存模组用量上限。当前主流服务器CPU平台内存通道数为8或12个，根据公开信息，明年量产的新一代CPU将支持16个内存通道，未来不排除相关内存通道数进一步增加，这意味着单颗CPU可支持的内存模组数量上限同步提升，为内存互连芯片带来增量空间。 3. DDR6标准推进，提升单模组芯片用量。JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，预计单根DDR6 RDIMM将配置数量更多的内存接口芯片，进一步提升单模组价值量。 以上三方面因素将共同推动内存互连芯片需求增长及市场规模扩大。
--	--

	问题3：请问公司如何展望明年内存互连芯片需求？ 答复：受益于服务器CPU需求增长推动，内存模组行业整体需求增加，将同步带动内存接口及模组配套芯片需求增加。 问题4：Arm架构的服务器CPU需要内存接口芯片吗？ 答复：内存接口芯片是JEDEC定义的标准化产品，其设计遵循统一的行业规范，可支持所有符合JEDEC标准的服务器CPU，并不限于特定CPU架构。无论是x86架构还是Arm架构，只要服务器CPU遵循JEDEC定义的内存接口标准，均可搭配使用相应的内存接口芯片。根据公开资料，多家北美云服务提供商自研的Arm架构CPU均支持DDR5内存模组，同样需要搭配内存接口芯片。 问题5：如何理解通过CXL技术实现存量DDR4的复用？ 答复：通过CXL内存扩展方案（需使用MXC芯片），可将存量DDR4内存接入服务器，作为CPU可访问的扩展内存使用。在当前DDR内存价格上行的背景下，该方案有助于客户降低内存扩容成本、延长存量资产使用周期。 问题6：请问如何预期MRDIMM未来的行业上量节奏？ 答复：MRDIMM今年处于第二子代产品规模试用阶段，其大规模上量需要等待支持第二子代MRDIMM的新一代CPU明年量产出货。MRDIMM对行业来说是新产品，其渗透节奏没有历史规律可以参考，建议投资人持续关注新一代服务器CPU平台的量产出货情况，以及下游采纳MRDIMM的进展。 问题7：公司目前在以太网互连领域有哪些新产品？ 答复：以太网和光互连芯片领域是公司战略布局的重要方向。公司在该领域官宣在研的首款产品是以太网 PHY Retimer芯片，该芯片主要用于保障AI服务器与交换机之间高速互连信号的完整性和可靠性。公司计划在今年完成以太网 PHY Retimer芯片工程样片的流片。该产品与PCIe互连芯片有着类似的客户群体，将进一步完善公司高速互连产品矩阵，为客户提供更具整体价值的解决方案。 问题8：公司PCIe Retimer芯片的出货情况如何，关于下一代产品的计划和进度
--	--

	如何？ 答复：目前，公司主要以PCIe 5.0 Retimer芯片出货为主，受益于国内AI服务器需求增加，推动PCIe Retimer芯片需求增长。今年上半年，公司已完成PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片量产版本流片，并在持续配合客户测试验证，该款芯片已成功列入PCI-SIG供应商名录。根据行业信息，支持PCIe 6.x Retimer芯片的标准服务器CPU平台预计明年量产出货。此外，公司正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发，计划今年完成工程样片的流片。 问题9：公司布局的产品越来越多，请介绍下关于研发技术人员的情况以及研发费用的趋势。 答复：公司持续引进兼具深厚专业积累与大型项目落地经验的海内外高端研发技术人员，截至2026年6月末，公司研发技术人员604人，占总人数的比例约为74.1%，硕士及以上学历的研发技术人员占比约65.2%，高素质研发技术人才梯队将为前沿技术迭代、新产品落地提供坚实保障。 2026年上半年，公司研发投入为4.53亿元，同比增长近27%，占营业收入的比例为13.6%。公司的研发费用主要由于研发技术人员薪酬、工程开发费用、相关工具及许可证费用等构成。随着公司在研项目越来越多，公司的研发费用绝对值预计将持续增长。公司会依据不同项目的技术阶段、市场前景与风险，对研发资源进行合理配置。 问题10：如何展望公司互连类芯片产品线未来毛利率趋势？ 答复：公司互连类芯片的产品品类越来越多，同一品类产品也在持续升级迭代，互连类芯片毛利率更多体现了多款产品的综合毛利率水平，与公司当期销售的产品结构相关。公司今年第二季度互连类芯片毛利率变化的主要原因是产品结构变化，毛利率相对较低的产品需求增长较快。从短期来看，一方面，DDR5新子代RCD芯片占比提升对毛利率有正向推动作用；另一方面，随着行业需求持续提升，在供给端会面临一定压力。从中长期来看，通过持续的子代迭代和新产品的推出，公司互连类芯片毛利率有望保持在较高水平。
是否涉及应披露重大信息的说明	无

附件	参与单位名称: Amundi Ashmore BlackRock Binyuan Capital Carmignac Cape Ann China Asset Management DRW Edmond de Rothschild Eurizon C Fideuram Fidelity Gemway Assets France Hermes Investment Newton Principal SG Polen Capital RCM Raiffeisen Kapitalanlage GM Veritas Asset Management LLP 富国基金管理有限公司 建信基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 中信里昂证券 浙商证券股份有限公司
----	---